

# ПОЗИТИВНЫЙ ФОТОРЕЗИСТ ФП-25МТ

Толстослойный фоторезист для экспонирования i-линией УФ-света. Может экспонироваться также интегральным светом в диапазоне 350-430 нм

Фоторезист предназначен для создания защитной маски при проведении операций глубинного и профильного травления кремния, а также гальванического осаждения металлов.

Фоторезист ФП-25МТ обладает более высоким контрастом и эластичностью пленки, по сравнению с фоторезистом ФП-25.

Фоторезист обеспечивает термостойкость профиля стенок до 120 °С. При дополнительном экспонировании коротковолновым ультрафиолетом 240-280 нм термостойкость может быть увеличена до 140 °С.

## **Рекомендации по применению**

### *Нанесение*

Центрифугирование при 2000 об/мин , в течении 2-х минут.

### *Сушка*

- Первая стадия: 20 °С, 20 мин.
- Вторая стадия: 95 °С, 30 мин.

### *Экспонирование*

Оптимальная доза экспонирования 150-200мДж/см<sup>2</sup> УФ-светом в диапазоне 350-430 нм.

### *Проявление*

Проявитель УПФ-1Б разбавленный дистиллированной водой, в соотношении 1:4, время проявления 45-50 сек при температуре 18-22 °С.

### *Задубливание*

- Первая стадия: 110 °С, 45 мин.
- Вторая стадия: 120 °С, 45 мин.

### *Удаление*

Для удаления пленки фоторезиста ФП-25МТ рекомендуется экологически безопасный сниматель СПР-01Ф или кислородная плазма.

### *Хранение*

Хранить в сухом помещении при температурах 10-21 °С в закрытых коричневых стеклянных бутылках. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев от даты розлива.